

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2022-047

## 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于全资子公司签订项目投资合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“公司”）全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司（以下简称“研究院”）与苏州科技城管理委员会签订项目投资合作协议，拟在太湖科学城新建先进化合物半导体光电子平台项目；

- 项目总占地面积约 31 亩，投资总额约 10 亿元。
- 风险提示

（一）本合作协议存在政策、市场变化对项目进展造成的不确定性影响。同时本合作协议约定的投资项目尚处于论证阶段，投资规模、建设周期、投资回报等数值均为预估数，项目建设过程中可能会面临公司根据实际情况调整的不确定因素。

（二）本合作协议涉及项目投资金额较大，未来资本市场环境变化及贷款利率波动，可能会对公司项目融资产生影响。未来公司通过银行贷款等方式筹措项目建设所需资金，可能对公司本年度经营性现金流和资金成本造成影响。

（三）本合作协议涉及项目投资具有投资周期长的特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、管理运营等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

（四）本合作协议所涉及的项目用地尚需通过国家现行法律法规规定的招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权成交价格、取得时间等存在不确定性。

(五)本合作协议所涉项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。

(六)本合作协议的签署对公司短期的经营成果不产生重大影响,对未来业绩的影响尚不确定。

(七)公司将根据项目进展的实际情况积极推进相关环节。公司将积极关注后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、 对外投资概述

### (一) 对外投资的基本情况

苏州高新区聚焦光子产业发展,推动产业链、资金链、人才链深度融合,以加速打造千亿级光子产业创新集群为目标,持续优化光子产业创新创业生态。为响应苏州太湖光子中心建设推进暨苏州高新区产业创新集群发展的号召,公司全资子公司“研究院”与苏州科技城管理委员会依据相关法律法规规定,于2022年12月27日签订了《苏州科技城管理委员会与苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司项目投资合作协议》(以下简称“合作协议”)。公司拟计划根据项目进程,合理分期投资自有资金及自筹资金10亿元在太湖科学城建设先进化合物半导体光电子平台项目(包括生产中心、研发中心和动力站及配套设施建设,设备采购及后期运营等)。项目计划2023年开工,2025年建成投产,本项目预计年产值不低于6亿元。该项目将依法依规得到苏州科技城管理委员会及各级政府政策支持,将依法依规尽快完成办理各项手续。

### (二) 决策与审议程序

公司于2022年12月26日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于签订〈苏州科技城管理委员会与苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司项目投资合作协议〉的议案》,同意公司全资子公司“研究院”与苏州科技城管理委员会签订本合作协议。根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定,此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。

## 二、合作协议主体的基本情况

### (一) 交易双方基本情况

甲方:苏州科技城管理委员会

地址:苏州高新区培源路3号软件大厦6号楼

苏州科技城管理委员会(甲方)是苏州科技城的行政管理机构,承担辖区社会、经济等事业的全面、科学、健康和可持续发展之促进、管理与服务等职责。

乙方:苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司

地址:苏州市高新区昆仑山路189号科技城工业坊-A区2号厂房-102 2号厂房-2-203。

成立日期:2018年03月08日

注册资本:5500万元人民币

法定代表人:闵大勇

经营范围:光电器件及系统的研发、开发、封装、销售;并提供相关技术咨询及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 苏州科技城管理委员会与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

## 三、合作协议的主要内容

### (一) 项目概况

1.1 项目内容:乙方计划在太湖科学城新建先进化合物半导体光电子平台项目,形成年产1亿颗芯片、500万器件的能力,具备氮化镓、砷化镓、磷化铟等激光器和探测器芯片的产线建设及器件封装能力,具备其他高功率半导体激光器芯片等功率芯片研发、封测能力(包括6-8寸器件封测生产线建设)。

1.2 投资规模：本项目计划投资额 10 亿元，计划建设总建筑面积约 46,293 平方米的生产中心、研发中心和动力站及配套设施。

1.3 项目所需载体：拟工业用地 31 亩。

1.4 产出规模：本项目预计年产值不低于 6 亿元，年纳税额 3410 万元。

## （二）合作内容

2.1 本次合作项目乙方拟申请 31 亩工业用地，用于建设生产中心、研发中心和动力站及配套设施。甲方将根据企业实际指标完成情况及用地空间调整等因素，拟推荐位于漓江路以东，普陀山路以北地块，土地面积约 31 亩，供地须符合苏州高新区产业用地相关供地要求并按规定办理土地出让手续。乙方承诺该项目投产后，项目地块亩均税收不低于 100 万元/年。

2.2 本合作协议签署后，甲乙双方将立即组织项目工作团队推进项目合作。

## （三）保密义务

甲乙双方对本协议涉及的技术及条款、内容负有保密义务，承担保密责任。未经甲乙双方一致同意，任何一方不得对外泄露上述保密信息。

## （四）其它事宜

4.1 项目建设用地依法采取“招拍挂”的出让方式提供（按挂牌文件设定的条件执行），乙方依法按程序参与竞买。如乙方未竞得土地，本协议自行终止。

4.2 由本协议引起或与本协议有关的任何争议双方应优先通过协商解决，协商不成的，应向项目所在地的人民法院提起诉讼解决。

4.3 本协议经双方法定代表人或授权代表签字及双方盖章，且经乙方股东大会审议通过后正式生效。本协议未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

4.4 本协议一式陆份，甲、乙双各执叁份，具有同等法律效力。

## 四、对外投资对上市公司的影响

本次投资的项目内容有利于提升公司的产品供应能力，进一步巩固和扩大公司的市场份额；有利于完善公司光电子产业链布局；有利于公司与地方政府实现优势互补、互惠。公司拟进行的项目建设将增加公司资本开支和现金支出，但对公司长期的业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司整体战略发展规划。本

协议签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、对外投资的风险

（一）本合作协议存在政策、市场变化对项目进展造成的不确定性影响。同时本合作协议约定的投资项目尚处于论证阶段，投资规模、建设周期、投资回报等数值均为预估数，项目建设过程中可能会面临公司根据实际情况调整的不确定因素。

（二）本合作协议涉及项目投资金额较大，未来资本市场环境变化及贷款利率波动，可能会对公司项目融资产生影响。未来公司通过银行贷款等方式筹措项目建设所需资金，可能对公司本年度经营性现金流和资金成本造成影响。

（三）本合作协议涉及项目投资具有投资周期长的特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、管理运营等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。

（四）本合作协议所涉及的项目用地尚需通过国家现行法律法规规定的招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权成交价格、取得时间等存在不确定性。

（五）本合作协议所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。

（六）本合作协议的签署对公司短期的经营成果不产生重大影响，对未来业绩的影响尚不确定。

（七）公司将根据项目进展的实际情况积极推进相关环节。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2022年12月28日